

富士フイルム 半導体用 CMP スラリーの製造・販売会社 米 Planar 社を完全子会社化

2010年12月2日

富士フイルム株式会社（社長：古森 重隆、以下富士フイルム）は、半導体材料の製造・販売子会社である FUJIFILM Electronic Materials U.S.A., Inc. を通じ、Wacker Chemical Corporation（本社：ドイツ ミュンヘン 以下Wacker社）が保有する半導体用CMPスラリー^{*1}の専門メーカー Planar Solutions, LLC（本社：米国 ミシガン州 以下、Planar社）の出資持分 50%を取得しました。富士フイルムは、2005年11月にArch Chemical, Inc. よりPlanar社の持分 50%を取得して以降、残りの持分 50%を保有するWacker社と共同でPlanar社の経営に携ってきました。2010年12月1日をもって同社を完全子会社化し、半導体用CMPスラリーの製造・販売会社としてFUJIFILM Planar Solutions, LLCをスタートさせました。

Planar社は、CMPスラリーで先進的技術に基づくトップ性能の製品を有するメーカーであり、米国・欧州やアジア地域の大手半導体メーカーに対し商品・サービスを提供しています。これまで、富士フイルムとPlanar社は研究開発や販売を中心に協働してきましたが、今回の完全子会社化により、Planar社の強みである高い商品開発力、コスト競争力および顧客対応力と、富士フイルムの先端技術との融合を加速させます。また、半導体デバイス製造の中心であるアジア地域に多くの販売拠点を持つ富士フイルムの強みを生かし、これまで以上にスピーディな顧客対応を実現していきます。

富士フイルムは高機能材料分野を重点分野の一つと位置付け、グループ会社である FUJIFILM Electronic Materials のアジア・米国・ベルギーの拠点を通じて、半導体製造工程で使用される材料・機器・サービスを幅広くグローバルに供給する体制のもとで、電子材料事業の拡大を図っています。

今後、CMPスラリーを商品ラインアップに組み入れることで電子材料事業のさらなる拡大を図るとともに、半導体デバイス産業の発展と繁栄に貢献していきます。

*1 CMPスラリー：半導体の製造プロセスで使用されるウエハーを平坦化するための研磨剤。

<FUJIFILM Planar Solutions, LLCの概要>

拠点：本社－Rhode Island州 North Kingstown、開発・生産拠点－Arizona州 Mesa

本件に関する報道関係のお問合せ
広報部 TEL 03-6271-2000